

보도시점 2025. 6. 22.(일) 11:00
<6.23.(월) 조간>

배포

2025. 6. 20.(금)

한국반도체아카데미, 비수도권 교육센터 2곳 추가 개소

- 올해 하반기부터 충남 아산, 경남 창원에 교육센터 개소
- 센터별 취업준비생 100명씩 연내 총 200명 추가 교육 계획

산업통상자원부(장관 안덕근, 이하 산업부)는 6.20.(금) 경남테크노파크(창원), 호서대학교(아산) 2곳을 한국반도체아카데미(이하 아카데미) 지역 교육센터로 선정하였다. 선정된 교육센터 2곳은 올해 하반기부터 취업준비생 200명을 대상으로 반도체 패키징과 테스트 교육과정을 추가적으로 운영할 예정이다.

아카데미는 한국반도체산업협회 주관으로 운영하는 반도체 종합교육기관으로, 2023년 개소한 이래 작년까지 약 1,800명의 취업 희망자와 기업 재직자를 대상으로 중소·중견기업 수요 기반의 이론·실습 교육을 제공해왔다. 현재 용인 교육센터에서는 장비개발 실습을, 판교 교육센터에서는 칩 설계 및 후공정 중점의 교육을 진행하고 있으나, 비수도권에는 교육센터가 없어 그간 교육생들의 불편이 지속되었다. 이번 선정을 통해 비수도권 거주 교육생들의 접근성을 높이고 인근 반도체 기업들의 인재 확보 어려움을 해소하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

지난 5.20.(화)부터 3주간 협회의 공고를 통해 총 5개의 기관이 신청하였다. 심사는 각계 전문가들이 참여한 가운데 △교육 운영역량, △인프라 보유현황, △산업계 참여 및 채용연계 방안 등의 기준을 바탕으로 진행하였으며, 발표 평가와 현장실사를 거쳐 경남테크노파크와 호서대학교가 최종 선정되었다.

경남테크노파크는 인근의 한국전기연구원(창원), 부산테크노파크(부산)와 협업하여 부산·경남 지역의 전력반도체 기업들이 필요로 하는 교육과정을 운영하고, 수료생들의 취업을 지원할 예정이다. 호서대학교는 대학이 보유 중인 후공정 전용 실습공간과 장비를 활용해 패키징·테스트 특화 교육을 제공한다. 특히 충남 지역에 밀집해 있는 반도체 패키징 기업과의 연계를 통해, 기업에 소속된 전문 엔지니어들이 직접 학생들을 가르침으로써 교육의 효과를 높일 계획이다.

한편, 산업부는 이번 교육센터 확장을 계기로 아카데미에서의 인재 양성 목표를

기존 연간 800명에서 1,000명으로 늘려 2027년까지 총 4,000명 이상 배출할 계획이다. 또한, 앞으로도 산업부는 아카데미 등 다양한 재정지원사업을 통해 반도체 실무인재 양성을 적극적으로 지원할 방침이다.

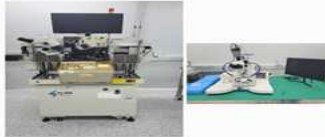
담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	주무관	배재현 (044-203-4254)



참 고

반도체아카데미 비수도권 참여기관(2개소)

□ 선정 기관 개요

연번	기관명	개요
1	경남테크노파크	[기관] '00년에 설립되어 기술 인프라 및 실증 지원을 위한 사업을 운영하고 있으며, 전략산업별 특화 센터 운영 중 [교육계획] 반도체 패키징·테스트 기초와 전문 심화 실습 과정 개발 부산TP와 전기연구원과 협업 기반 특화 교육 운영 추진 - (기초) 전력반도체 신뢰성 실무 및 반도체 후공정 현장연계 교육, 전력반도체 공정 및 패키징 기초 실습 과정 - (심화) 전력반도체 신뢰성 평가, 패키징 이론 및 해석, 반도체 소자 공정 및 패키징 실습 특화 과정 [보유인프라] 경남TP, 부산TP, 전기연구원 인프라와 관련 장비 활용 - 경남TP: 반도체 공정 및 테스트 장비 - 부산TP: 전력반도체 FAB 공정장비 및 신뢰성 평가 장비 - 전기연구원: 전력반도체 장비 및 SW
		
2	호서대학교	[기관] 충남 아산 소재 사립대학으로, 명지대와 함께 '23년 반도체 특성화 대학(소부장, 패키징 분야)으로 선정되어 운영 중 [교육계획] 패키지 기초교육과 패키징 단위공정 및 종류별 실습 특화 - (기초) 반도체 패키징 기본 원리와 실습 이해 - (심화) 반도체 패키징 실습·분석 특화 교육(쏘잉, 본딩, 몰딩 등) [보유인프라] 자체 후공정 전용 교육·실습공간과 관련 장비 활용 - 쏘잉, 다이본더, 와이어본더, 몰딩, 마킹 등 패키징 장비 - 테스터, 스코프 등 테스트·분석 장비
		1 Sawing Machine  2 Die Bonder(Auto/Manual)  3 Wire Bonder(Auto/Manual)  4 Molding System  5 Laser Marking  6 Trim/Form System 